

内容提要

A. 活动回顾

IC企业代表“科技赶集” 共建“科技大市场” 提升产业创新能力
中国半导体市场年会“新十八号文”权威解读陕西企业喜获创新奖

B. 西洽会专题

聚焦新兴产业 西洽会签约大揽金

C. 焦点关注

2010年中国集成电路市场强势反弹 规模达7349.5亿元

D. 地方资讯

展现产业优势 力促战略合作 IC产业西洽会高调亮相
两知名IC设计企业组团考察西安
美光半导体新测试项目厂房正式落成

E. 产业动向

IC设计并购四起 大者恒大的掌声背后
中国制造业发起“造心”攻势
美国光伏项目未结订单超过12GW 预示市场仍将增长
2011年全球LED晶粒价格有望年减约20%

F. 科技新品

清华自主研发立体视频芯片
西安交通大学成功研制高清立体显示处理芯片

G. 公告通知

关于2011年集成电路设计企业认定和年审的通知
关于组团参展深圳集成电路创新应用展的通知
关于陕西省半导体行业协会会费的通知



IC 企业代表“科技赶集” 共建“科技大市场” 提升产业创新能力

2011年4月2日，西安科技大市场启动仪式在西安高新区都市之门隆重举行。市委常委、副市长李秋实，省科技厅副厅长孙科，市委常委、高新区管委会主任赵红专，市人大副主任李尊贤，市政协副主席李佐成，市科技局局长问向荣，高新区党工委副书记、管委会副主任刘明华等领导出席了启动仪式，启动仪式由赵红专主持。来自政府、高校、院所、企业、中介结构相关负责人及科技大市场入驻机构代表共计300余人参加了活动。

开幕式上，市科技局局长问向荣详细介绍了西安科技大市场的相关情况，市委常委、副市长李秋实，省科技厅副厅长孙科分别在开幕式上做了重要讲话。市人大副主任李尊贤、市政协副主席李佐成、西安交通大学副校长宋晓平和高新区管委会副主任刘明华共同开通科技大市场网络平台，李秋实副市长、省科技厅孙科副厅长共同为科技大市场揭牌。西安交通大学、西安近代化学研究所及深圳市创新投资有限公司做交流发言。

与启动仪式同时举行的“科技大集市”也如火如荼的进行，西安市集成电路产业发展中心组织了13家企业参加了此次集市展示，作为集成电路行业的企业代表，同样在技术与市场合作中有着迫切需求，尤其IC设计企业，有着得天独厚的技术优势，通过科技大市场平台，发布技术供需信息，扩大技术交易规模，并与高校院所、军工单位、大型企业合作，建立仪器设备共享信息平台，提高公共资金投资的仪器设备利用率和企业技术创新能力，达到“聚集大资源，满足大需求”的目标。

据了解，西安科技大市场目前已基本具备技术交易、设备共享、政策服务、人才创业和合作交流等方面的服务功能，每月将固定一天作为“科技赶集”的日子，为市场供需方提供服务。之所以称之为“大”市场是因为，第一，西安有大量的技术、成果、人才、信息等科技资源，需要通过市场让企业知晓；第二，大市场服务大厅集聚了专业化的中介机构，形成“一站式”服务，形成大服务平台；第三，政府搭建一个开放的大服务平台，高校、院所、企业和中介机构共同支持大市场的建设，共同分享市场资源，以政策集成服务，帮助企业了解、用好用活政策，打造“科技大集市”的交流品牌，引领“科技赶集”理念和风尚。

目前，西安市2010年技术交易总额57.3亿元，位居全国第二，通过科技大市场的带动，2011年预计达70亿元，2012年突破100亿元，2015年力争达到300亿元的交易额。

中国半导体市场年会 “新十八号文” 权威解读 陕西企业喜获创新奖

2011年3月2日，“2011年中国半导体市场年会（IC Market China 2011）”在苏州工业园区独墅湖会议酒店举行。会议吸引了数百位全球半导体业内权威人士及行业精英，大家就“半导体行业走势、芯片创新、绿色商机”等问题展开讨论。中国电子信息产业发展研究院党委书记洪京一、国家工业和信息化部电子信息司副巡视员李勃华、中国半导体行业协会理事长江上舟等出席会议，并从“产业规模、技术水平、企业发展”三个层面对中国半导体10年来的发展进行了回顾。基于产业发展，结合近期发布的“新十八号文”的进一步解读，江上舟认为，“十二五”期间，在国家最新政策的指引下，中国半导体产业将迎来又一个“黄金时代”，我国设计、制造乃至设备和材料企业竞争力不足的现象将得到改观，我们在半导体产业链的各个环节，特别是战略性新兴产业中的“四大支柱、三大先导”都将出现一种强劲的发展势头。

会议的另一个议题——第五届（2010年度）中国半导体创新产品和技术项目获奖也引起了业界关注，获奖企业及其技术36项，其中西安隆基硅材料股份有限公司的多晶体“碳头料”硅碳分离的腐蚀液及其制备方法也在其列，此次获奖也进一步证实了西安在材料方面的研发实力。

SEMICON China 2011 在上海隆重召开

2011年3月15日，SEMI旗下国际大半导体、平板显示及太阳能光伏产业盛会SEMICON China / FPD China / SOLARCON China 2011在上海浦东新国际展览中心拉开了帷幕，全球五大龙头芯片制造企业领袖首聚开幕式，中芯国际、Intel corporation、宏力半导体、GLOBALFOUNDRIES及上海华虹NEC的高层都发表了精彩的演讲。

此次展会的展区分为LED制造专区、二手设备及一站式服务系统专区、IC设计、制造及应用专区，占地共46000平方米，参展企业超过1000家。展会期间，还设立了中国先进汽车电子应用与机遇研讨会、“LED照亮未来”国际研讨会等多个研讨会。

陕西省半导体行业协会受SEMI邀请参加了此次行业盛会。通过此次展会了解到，在LED方面，2010年新增约170余台MOCVD设备在大陆安装，预计到2012年底中国MOCVD设备总量将达到1030台，2010年行业新增102万人，中国正成为全球最大的LED制造基地，预计到2015年，中国大陆的LED芯片产能位列全球第一；在IC设计与制造方面，90nm和65nm已经顺利量产，45nm量产在即，最先进的32nm也已研发立项，目前，中国的IC设计产业已占全世界的近20%。在政府“十二五”规划的引导下，中国半导体产业在未来五年内将会迎来下一个快速发展的“黄金时期”，产业将迅猛发展，整体实力将大幅提高。

2011年西安邮电学院微电子专业实习培训顺利举办

2011年3月15日,西安邮电学院,西安市集成电路产业发展中心联合 spring soft, 为该校微电子和集成电路专业学生进行了实习培训,本次培训的主要目的是将理论和实践相结合,让同学们深入的了解数字集成电路在设计过程中的 EDA 工具,加深对数字集成电路设计的认识,培养学生分析问题,解决问题的能力,使其能尽快适应今后的工作岗位,增强自身竞争力。

其间西安集成电路产业发展中心还在西安软件园报告厅对参与培训的学生作了《关于集成电路产业发展和人才需求》的专题报告,帮助学生对所专业的产业现状和发展趋势有所认识 and 了解,为自身的择业和职业定位提供参考。

本次实习培训的得到了邮电学院老师和学生的一致好评,为期一周的西安邮电学院微电子专业大四学生实习培训在我中心的组织和培训下顺利完成。

“LED 照明电源（西安）技术研讨会”圆满结束

2011年3月16日,由西安市人民政府、成都市人民政府等单位主办的第十二届中国西部国际装备制造业博览会(简称“制博会”)在我市拉开帷幕,展会为期4天,展场分设在西安绿地笔克国际会展中心和曲江国际会展中心,共10大展馆。本届展会参展企业1500余家,创历届之最。我协会会员单位西安明泰半导体科技有限公司和陕西天宏硅材料有限责任公司参加展会,并展示了各自的技术和产品。

3月16日上午,由陕西省电源学会和西安明泰半导体科技有限公司主办的“LED 照明电源(西安)技术研讨会”同期举行,会议邀请了本地 LED 照明领域的相关企业和高校院所,参会人员超过50人。会上,专家就 LED 产业发展现状、影响 LED 的关键因素及 LED 驱动电源关键技术进行了分析。陕西省半导体行业协会秘书长何晓宁就“陕西 LED 产业现状与发展趋势”做了报告。本次研讨会为企业后续研究提供了参考性意见,使参会代表对 LED 及其驱动电源有了更为深入的认识。

陕西多家集成电路生产企业成为“国家鼓励的集成电路企业”

2011年4月6日,国家发改委、工信部、海关总署和国家税务总局共同发布“关于发布2010年度国家鼓励的集成电路企业名单的通知”。在此名单中的投资额超过80亿元人民币、线宽小于0.25微米、线宽小于0.8微米(含)的集成电路生产企业可享受财政部和国家税务总局“财税[2008]1号”文件有关优惠政策。

其中陕西地区的西安西岳电子有限公司、西安微电子研究所、西安西谷微电子有限责任公司等获得此认定。

全国集成电路行业工作会议暨中国集成电路产业十年成就展

2011年4月15日至16日，全国集成电路行业工作会议在北京国家会议中心召开，同期举办了“中国集成电路产业十年成就展示”。来自工信部、财政部、科技部、发改委等政府司局的领导，全国各省市自治区的地方主管部门领导、企业代表，及行业协会的代表近300人出席此次会议。

2011年初，随着《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)的正式发布，我国软件产业和集成电路产业迎来了更加优越的发展机遇。同时，2011年也是“十二五”的开局之年，工信部电子信息司在时隔十年之后再次召开全国集成电路行业工作会议，通过系统总结过去十年的成功经验和教训，对“十二五”期间产业发展做出规划和部署，帮助集成电路企业和行业主管领导认清形势、增强信心、找准对策，力争在“十二五”期间使集成电路继续保持快速发展的势头，为电子信息等行业实现技术创新、促进节能减排、推动产业升级和转型提供有力支撑。

中国集成电路产业十年成就展示与行业工作会同期举行，共有38家集成电路设计企业、6家集成电路及分立器件制造企业、6家集成电路封装测试企业、10家半导体设备、仪器及材料企业，以及4家集成电路公共服务机构在此次成就展示上集中亮相，展示十年来我国集成电路产业在技术创新、产品创新、服务创新上所取得的骄人成就。其中陕西地区参加此次活动的有西安芯派电子科技有限公司、西安微电子研究所、西安西岳电子技术有限公司和西安优势微电子有限公司这四家企业。

此次展览的展区面积达700平米，展览形式不仅有传统的平面图展示，很多设计企业还在现场摆放了有代表性的主打产品和最新推出的集成电路产品。制造企业展示的晶圆，封测企业展示的封装产品和设备，以及材料和设备企业的丰富展品，过平面展板、多媒体音视频和实物展示相结合，全面生动地展示十年来我国集成电路产业所取得的巨大成就。

聚焦新兴产业 西洽会签约大揽金

4月6日上午,第十五届中国东西部合作与投资贸易洽谈会在西安曲江国际会展中心拉开帷幕。全国人大常委会副委员长严隽琪,中国国民党荣誉主席吴伯雄,中共陕西省委书记、省人大常委会主任赵乐际,陕西省省长赵正永,甘肃省省长刘伟平等出席开幕式。在此后的五天时间里,中外客商将云集西安,深入商洽投资贸易合作,共同为深化区域大合作、推进西部大开发献计出力。

高新区:

38个项目总引资额481.5亿

本届西洽会上,高新区园区环境草绿花红,令人耳目一新;总引资额创历届西洽会之最,签约项目亮点频出;宣传报道频频见诸报端……高新区,在本届西洽会上无疑成了众多区域中最耀眼的一颗星。4月14日,高新区召开第十五届西洽会总结会,各个小组在会上总结成绩,发现不足,积累经验。高新区管委会副主任杨仁华参会。

杨仁华肯定了此次西洽会上高新区的总体表现。他说,各个小组在此次西洽会上都表现很好,付出了很多的心血和努力,也得到了上级领导的表扬与肯定。西洽会期间,各个小组的负责人亲自上会,紧盯细节,不少同志带病上岗,最终取得了不错的成绩,各个小组的工作都可圈可点:签约项目亮点多,宣传报道有新意效果佳,环境布置形式创新。希望大家在总结成绩的同时,再接再厉,寻找问题,在下一届西洽会上,做出更好的表现。

据了解,本届西洽会西安高新区共签约38个项目,总引资481.5亿元,创历届西洽会之最。其中外资项目9个,5家世界500强企业,外资投资总额14.19亿美元;内资项目29个,投资总额389.25亿元。

经开区:

50项目签约总投资361亿元

国家西部大开发战略和关中天水经济区发展规划的深入推进,使经开区作为“西安城市中枢、新兴产业高地”的复合平台优势进一步彰显——十五届西洽会,包括BP、ABB、阿尔斯通、日立、赛峰等5家世界500强,及中航重机、中国兵器、北车集团等在内的众多国内外龙头企业先后“落子”西安经开区,共签约50个项目,总投资361亿元,单个项目平均投资超过7亿元。

在西洽会战略性新兴产业签约仪式上,深圳远古、广联达、鹰之航等国内行业知名企业,将经开区作为其拓展服务外包领域的“目标地”,共设立5个项目,总投资超过9亿元。与此同时,赛峰、阿尔斯通、日立、ABB等另外四家世界500强投资项目

也落户经开区。五家企业项目总投资达到 2.5 亿美元，刷新了经开区在西洽会上与世界 500 强投资合作的项目数。

西安出口加工区：

四项目揽金 11.4 亿元

在第十五届中国东西部合作与贸易洽谈会上，西安出口加工区凭借良好的投资环境和优惠的政策平台，受到中外客商的高度关注，共签约 4 个项目，总合同金额折合人民币 11.4 亿元。

4 月 7 日，西安出口加工区与碧辟普瑞太阳能有限公司签署了光伏组件、光伏系统集成项目入区协议。碧辟普瑞太阳能有限公司于 2005 年由英国 BP 太阳能公司及新疆新能源股份有限公司在出口加工区共同投资设立，是目前我省乃至西部地区最大的专业太阳能光伏组件生产企业。该项目总投资 12000 万美元，征地 116 亩，用于生产光伏组件、光伏系统集成等一体化的产品。项目建成后，将形成 500MW 年生产能力，预计 2015 年实现销售收入 50 亿，进出口额达到 15 亿美元以上。

4 月 8 日，西安出口加工区又分别与三个项目举行了签约仪式。其中与中国航空制造业首家上市公司西飞国际和世界 500 强法国赛峰集团共同签署的飞机发动机短舱生产项目，总投资 1800 万美元，租用厂房 7400 平方米，主要从事开发、制造和销售商用飞机短舱系统组件和部件，达产后年产值 2 亿元人民币。

国际港务区：

投资 15 亿 陕西省物联网应用产业园落户西安国际港务区

4 月 6 日，由陕西省工业和信息化厅主办的第十五届中国东西部合作与投资贸易洽谈会战略性新兴产业项目推介与签约会在钟楼饭店二楼多功能厅举行。省政府批准国际港务区建设“陕西省物联网示范园”，副省长吴登昌向副市长、国际港务区党工委书记、管委会主任韩松授牌。这是省政府进一步响应国家深入推进西部大开发战略，打造关中—天水经济区龙头，促进大西安国际化战略的实现，助推西安、陕西现代服务业发展，提升信息产业综合竞争力的重要举措。同时，强晓安与陕西烽火通信集团有限公司董事长李荣家签署战略合作框架，投资 15 亿元人民币，共建“国家级物联网应用产业园”。

据悉，陕西烽火通信集团有限公司是陕西电子信息集团所属的大型军工电子企业，是陕西在 RFID 技术研究、RFID 应用系统集成、电子标签和智能卡的研发、生产方面的重点企业，也是我省物联网应用的代表性企业。

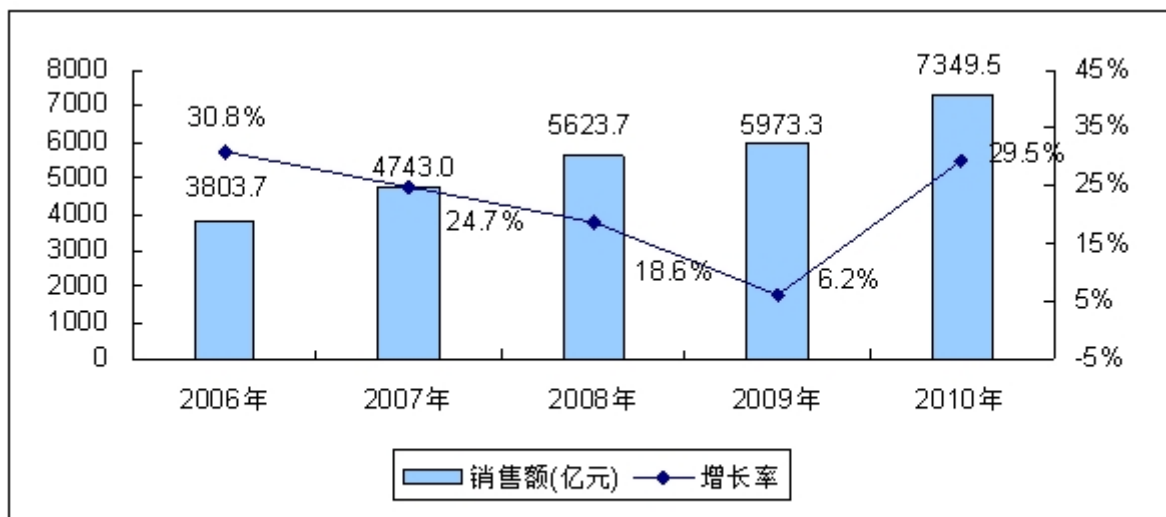
2010 年中国集成电路市场强势反弹 规模达 7349.5 亿元

(来源: 中国半导体行业协会)

1、2010 年中国集成电路市场规模 7349.5 亿元, 市场增长 29.5%

2010 年全球半导体市场规模 2983.2 亿美元, 市场增速达 31.8%, 是继 2000 年以来市场增速最快的一年, 在经历的 2009 年的下滑之后, 市场大幅反弹, 结束了连续多年来的低迷发展态势。

中国集成电路市场方面, 市场也同样结束了连续多年来增速连续下降的趋势, 2010 年市场增速达 29.5%, 实现销售额 7349.5 亿元。是继 2005 年之后市场增速最快的一年。市场的反弹得益于全球经济的复苏, 市场对下游整机电子产品的需求旺盛, 从而带动对上游集成电路产品的需求。此外, 由于 2010 年下游市场对芯片需求强劲, 因此整体上使得芯片价格相对往年较为坚挺, 在某些产品领域甚至出现芯片价格上涨的现象, 芯片价格因素也是影响市场发展的因素之一。整体来看, 2010 年之所以能实现市场的大幅反弹, 关键的因素还是因为 2009 年市场受全球金融危机影响造成衰退, 从而导致市场基数较低, 因此 2010 年全球市场和中国市场双双实现高速增长。



数据来源: 赛迪顾问 2011, 02

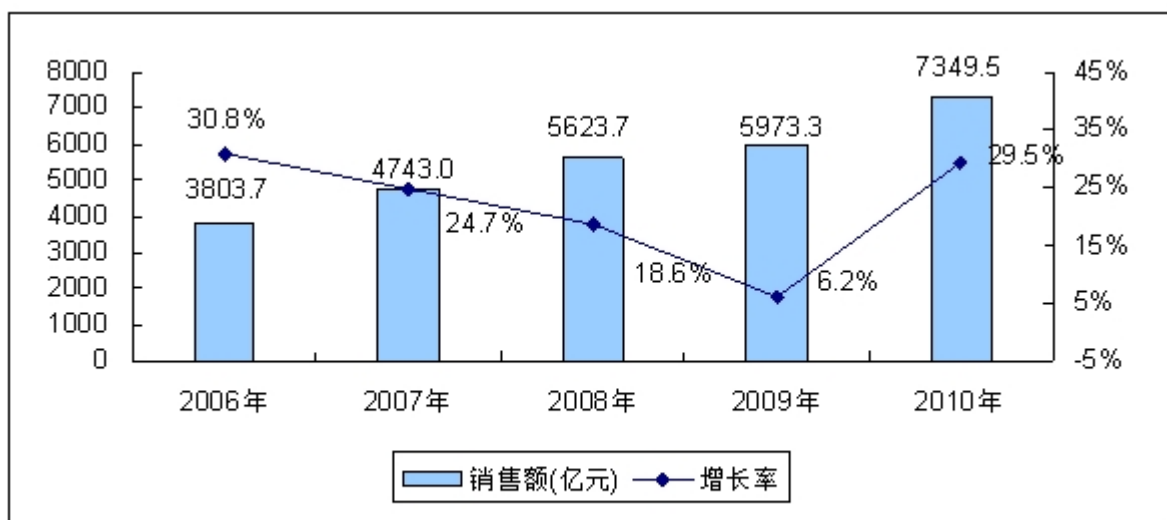
图 1 2006—2010 年中国集成电路市场销售额规模及增长率

市场进出口方面, 根据海关的统计数据, 2010 年, 中国集成电路进口额达 1569.9 亿美元, 同比增速 31.0%, 出口方面, 中国集成电路 2010 年出口额为 292.5 亿美元, 同比增速 25.5%。可以看出, 中国集成电路产品进出口差额较大, 中国所需的集成电路多数仍然需要进口, 中国集成电路市场的发展速度也基本与进口规模的增速保持一致。

2、存储器增长快速, 是中国集成电路市场份额最大的产品

在产品结构方面, 受益于市场整体保持快速增长, 几乎每种集成电路产品都保持了较快的增速, 其中存储器受到来自各个应用领域的带动, 增速最快, 增速超过 40%, 市场份额达 23.9%, 依然是中国集成电路市场份额最大的产品。CPU 和计算机外围器

件则受到笔记本产量增速相对稍缓的影响，市场份额有所下滑。

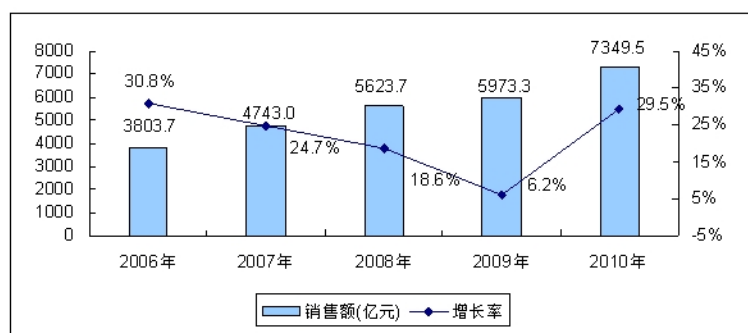


数据来源：赛迪顾问 2011，02

图2 2010年中国集成电路市场产品结构

3、3C 领域仍是主要应用市场

从市场应用结构来看，2010年，汽车电子领域依然是中国集成电路市场发展最快的领域，全年市场增速达36.8%，其市场份额稍有上升，但由于其市场基数本身较小，因此对整体集成电路市场的带动作用有限。计算机领域依然是中国集成电路市场最大的应用领域，2010年市场份额为45%，由于2010年中国笔记本电脑相对于其他主要的电子整机产品产量增速稍缓，因此计算机领域集成电路市场的份额较2009年也稍有下滑。网络通信和消费电子领域则分别受到手机以及家电产品产量大幅增长的带动，其市场增速都保持在30%以上。整体来看，PC和手机仍然主宰集成电路市场的发展，二者所消耗的集成电路产品超过集成电路整体市场的一半，然而随着其它各类产品应用的增加，这两类下游产品所占的市场份额将缓慢缩小，但未来几年，这两类产品仍然是集成电路消耗市场的主导产品。



数据来源：赛迪顾问 2011，02

图3 2010年中国集成电路市场应用结构

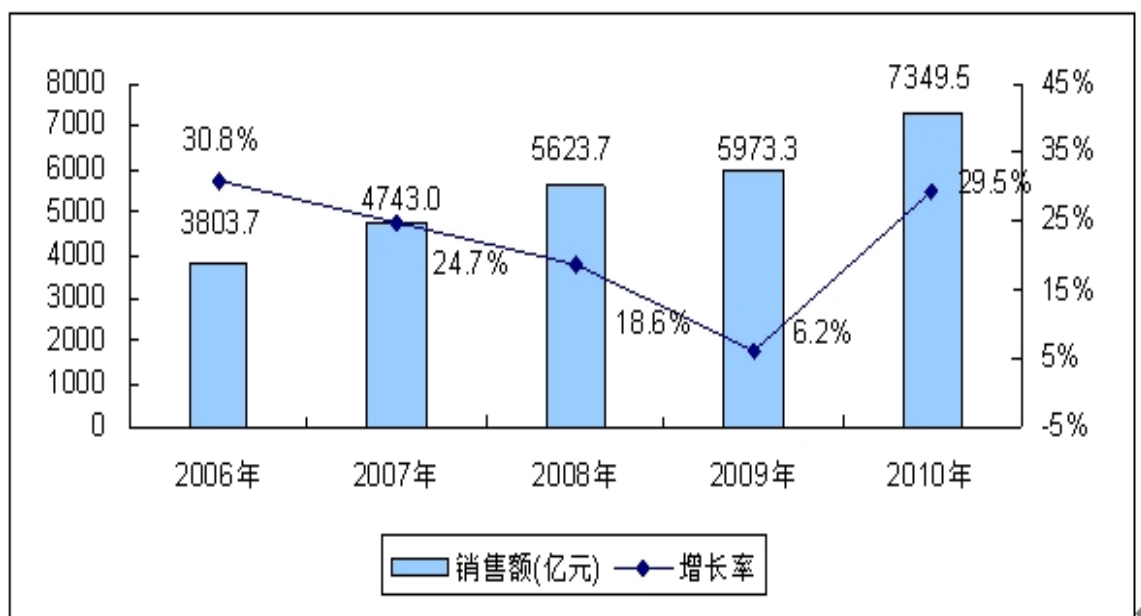
4、整体竞争格局基本不变，联发科技发展放缓

竞争格局方面，2010年中国集成电路市场基本保持了之前的态势，欧美日韩厂商依然占据了明显优势，英特尔第一的地位暂时还没有厂商能够撼动，但是三星与英特尔的差距基本上市逐年减小。其它企业方面，Micron和瑞萨则由于收购或合并，销售额大幅增加，排名有所上升，TI、英飞凌等企业也表现出强劲的增长力，值得注意的是，前两年一直保持高速发展的中国台湾企业联发科技在2010年由于受到市场竞争激烈的影响，其发展势头有所减缓，排名下滑。

5、未来几年市场将保持平稳发展态势

展望2011年，在经历了2010年的高速增长之后，无论是全球市场还是中国市场，市场将会进入平稳发展的阶段，预计市场增速将在10%左右，市场发展的主要驱动力仍然主要来自PC、手机、液晶电视已经其它产量较大的电子产品。此外，未来新兴应用成为市场增长的推动因素之一，xPad等新兴电子产品市场的发展也在一定程度上推动了半导体市场的发展，随着医疗电子、安防电子以及各个行业的信息化建设的持续深入，应用于这些行业的集成电路产品所占的市场比重将会越来越多。

未来3年，汽车电子的增速将会明显放缓，但依然将明显高于整体集成电路市场的增长，PC领域的增速也将会有所放缓，这将直接影响到存储器市场和CPU市场的发展，值得注意的MCU产品，未来随着社保卡发卡量的增加，用于IC卡领域的MCU将会受到带动，而且随着MCU应用范围的拓宽，中国MCU的增速将明显快于整体集成电路市场。



数据来源：赛迪顾问 2011，02

图4 2011—2013年中国集成电路市场规模及增长率预测

展现产业优势 力促战略合作 IC 产业西洽会高调亮相

2011年4月6日上午9:00,第十五届中国东西部合作与投资贸易洽谈会正式开幕,由陕西省半导体行业协会组织的7家企业参加了展会。作为“新一代信息技术”展区的一部分,集成电路专区以设计技术、产品演示、全方位服务平台为特点,充分展示了腾飞中的陕西集成电路产业的发展风貌---创新活力、发展潜力是陕西省集成电路产业的发展目标,积极推动着产业创新,通过西洽会这一重要载体充分展示了产业优势,实现区域合作与交流,促进了企业跨越发展。

4月6日下午2:30。第十五届中国东西部合作与投资贸易洽谈会战略性新兴产业项目推介及签约仪式在钟楼饭店举行,陕西省副省长吴登昌、省工信厅厅长蒋跃和副厅长田力、许蒲生、西安市副市长韩松、西安航天科技产业基地管理委员会主任陈长春、西安经开区管委会主任贾生林等出席会议,有关园区、企业领导、省内外客商代表参加会议。

本次推介及签约仪式由陕西省政府和陕西省工信厅主办,共签约25个项目,金额约253亿元人民币,涉及电子产品研发、太阳能光伏以及软件开发等领域。在项目推介与签约仪式上,吴登昌副省长向西安国际港务区授予“陕西省物联网示范园”称号、向西安航天基地授予“陕西省云计算产业示范基地”称号;田力副厅长作了陕西省战略性新兴产业“十二五”发展方向和重点介绍,内容主要包括陕西战略发展现状、“十二五”战略新兴产业发展目标和陕西发展新兴产业潜力与优势等。

西安高新区推广 LED 路灯受表彰

4月11日,由高新区市政配套服务中心组织实施的道路照明基础设施项目被评为“西安市推广高效节能半导体(LED)产品示范工程”,获得西安财政局、科技局和发改委115万元的专项资金补助,同时被授牌表彰。

自2006年以来,高新区先后实施建设了高新区路灯控制平台,实现数字化、人性化调控,采取多种节能措施,在辖区积极推广路灯节能照明,同时对半导体(LED)照明进行探索,在科技六路专门设立测试路段,对灯具的寿命、显色性、单位功率和路面照度等专业性能进行统计和分析,全面测试性能,为今后在辖区大力推广此项节能技术奠定了基础。

2010年,市政配套服务中心积极投入“十城万盏”半导体(LED)照明产品示范工程的活动中,先后对新建的西太路、西沔路等8条道路;区内唐延路、沣惠路等20条路段路灯安装及改造均采用LED光源,超额完成了西安市下达给高新区3500套半导体照明试点指标,现LED路灯照明已占到全区路灯照明总量的30%以上,节能40%以上,效果显著。

两知名 IC 设计企业组团考察西安

2011年3月8日,台湾联咏科技和中颖电子两家业内知名 IC 设计公司组团到西安高新区考察,对产业发展环境给予了高度的评价“高新区的各项优势非常适合 IC 产业发展”。

西安是国家级 IC 设计产业化基地,发展 IC 产业的条件得天独厚。高新区更是汇集了一批服务于 IC 设计的软件企业,借助国家建设关中——天水经济区以及西安建设国际化大都市的政策,高新区正全力建设世界一流科技园区,发展潜力极大,是联咏科技等 IC 设计企业下一步发展的良好选择。希望各企业代表以此次考察为契机,加深对西安高新区的了解,为进一步开展合作打下良好基础。

台湾联咏科技公司高级经理林正寰对高新区的发展给予了高度的评价,认为西安基础设施完善、交通便利,高新区园区环境优美、人才资源优势突出,人才稳定性强,联咏科技计划在高新区建立研发中心,辐射中西部地区。一同来访的中颖电子股份有限公司副总经理郭志升也表示看好高新区的发展,准备布局西部,在高新区建立西部地区的研发中心。

台湾联咏科技公司是台湾 IC 设计领导厂商,主要产品为全系列的平面显示荧幕用驱动 IC,以及行动装置及消费性电子产品上应用的多媒体单晶片产品解决方案。公司 2010 年营业收入超过 85 亿元人民币,是台湾第二大芯片设计公司。中颖电子主要从事集成电路设计与研发,曾被评为中国最有潜力的 IC 设计公司之一,其在微波炉、电磁炉和电动自行车控制芯片等多项应用领域取得了全球市场占有率第一的成绩。

高科卫光再获国家实用新型专利证书

继 2007 年获得由国家知识产权局颁发的“一种单灯双光源结构的大功率极”、“发光二极管组合灯”的实用新型专利证书后,近日高科卫光公司再次获得“带散热器的高效通用型 LED 灯管”的实用新型专利证书。

这一实用新型专利凝聚着公司 LED 照明工程技术研发团队的汗水和心血,也是高科卫光取得的又一重大科研成果。截至目前,高科卫光已获得三项 LED 技术专利,不仅提高了企业的核心竞争力,也增强了企业的发展后劲,为落实公司确定的“快速发展 LED 照明产业”2011 年发展战略奠定了坚实基础。

据悉,继紫薇尚层泛光照明工程、大唐西市景观树工程后,由高科卫光公司承担的第三个 LED 景观树亮化工程 2 月份完成,211 棵 LED 景观树已在大雁塔广场、大唐芙蓉园、曲江南湖、大唐不夜城等曲江四大景区炫丽亮相,业已成为古城春节期间的一道靓丽风景线。

中国移动西安投资 160 亿建设无线城市

2011年4月12日,中国移动通信集团公司与西安市政府举行“无线城市”建设战略合作协议签字仪式,中国移动通信集团公司总裁李跃、西安市市长陈宝根出席仪式。根据协议,双方将按照“发挥优势、相互促进、长期合作、互利共赢”的原则,共同实施推进西安无线城市建设。双方将在多领域展开合作:中国移动2G/3G(TD-SCDMA)/WLAN多重网络的建设和应用、信息基础设施建设、政务和民生信息服务、物联网应用、网络和信息安全建设等,从而为政府、企业和市民提供全方位的信息化服务,促进信息产业发展,提升城市综合竞争力,为使西安建设成为国际化大都市奠定坚实基础。

“十二五”期间,中国移动将发挥网络优势、资源优势、客户优势、品牌优势,在西安投资超过160亿元,加快建设无线城市信息基础设施,加大科技创新合作力度,全面推进无线城市重点应用,积极开展无线城市物联网应用,全面推进网络和信息安全保障应用,带动相关产业发展并提供超过2万个就业岗位。

美光半导体新测试项目厂房正式落成

4月19日,美国美光科技有限公司半导体新测试项目在西安出口加工区B区正式落成,标志着美光在我市高新区建设的超大规模集成电路加工生产基地再次扩产成功。市委副书记、市长陈宝根,市委常委、高新区管委会主任赵红专,副市长金学锋,市政府秘书长张建政,美光科技全球运营副总裁霍金斯出席落成典礼。

美光科技公司2005年9月12日在西安高新区投资2.5亿美元,建立半导体封装测试生产基地,成为陕西省改革开放以来最大的外商投资项目。2007年3月项目完成16500平方米的厂房建设,开始半导体测试和模块装配业务。西安公司的发展非常成功,目前员工人数已超过千人,并且是美光在全球最大的半导体测试厂。2010年2月2日,西安高新区与美光签署新投资项目合作协议,在原有2.5亿美元的基础上,决定新增投资3亿美元,建设半导体新测试项目;该项目紧邻美光一期生产厂房,将成为美光科技创新产品(包括固态硬盘、发光二极管、太阳能、显示器等具有世界一流技术水平的产品)制造基地。

目前,美光在亚洲的业务已占据公司年收入的70%以上,此次新落成的38000平方米厂房将更好地满足美光亚洲区客户的需求。新厂房投产后,可实现全年出口加工货值30亿美元,到2013年超过50亿美元,总计将吸纳就业4500人。

集成电路产业是我市和高新区重点发展的战略产业之一。美光公司半导体新测试基地的建成,将对高新区乃至西安半导体产业链的完善起到重要的推动作用,西安也将因此跨入中国一流、世界知名的集成电路产业基地。

西飞国际、美国雅奇国际航空材料项目落户西安

4月13日,西安经开区与中国航空工业集团西安飞机国际航空制造股份有限公司(简称西飞国际)、美国雅奇国际有限公司(简称美国雅奇)签署了国际航空材料项目投资协议。西安市政协副主席、经开区党工委书记郭学民,经开区管委会主任贾生林,经开区管委会副主任段永和,西飞国际副总经理许杨,美国雅奇董事长 PAUL MARKS 等领导参加了签约仪式。

西飞国际在2010年11月召开的第八届中国国际航空航天博览会(珠海航展)上,已经与经开区签订了战略合作协议,此次签约标志着西飞国际与经开区的合作进入实质阶段。西飞国际是中航工业集团首家中国航空制造业上市公司,是中航工业集团整机制造、销售的龙头企业;美国雅奇是航空界认可的全球知名的航空复合材料供应商,与世界顶级的航空材料供应商建立了长期的合作关系,产品广泛用于波音、空客、庞巴迪及国内民用飞机 C919、ARJ21、新舟 60 等。此次西飞国际、美国雅奇在西安经开区所属的陕西西安出口加工区 A 区投资设立的国际航空材料项目首期投资 1000 万美元,租用 1300 平方米仓库,主要为国内外航空企业提供航空复合材料加工、分拨和配送等进出口业务,运营后年进出口额约 3000 万美元。经开区为项目建设提供包括仓库、基础设施配套等多方面的全力支持。

西安经开区和西飞国际、美国雅奇强强携手,实现共赢发展,这是在实施国家西部大开发战略、“关中—天水经济区”发展规划获批和西安建设国际化大都市的大背景下三方展开全方位合作的具体举措。

半导体

IC 设计并购四起 大者恒大的掌声背后

类比晶片市场大整并，德仪(TI)宣布以总额 65 亿美元并购国家半导体(NS)，德仪为全球最大的类比 IC 龙头厂，市占率约 14%，而国家半导体为全球第七大，两者相加后，德仪未来在全球类比晶片的市占将达 2 成以上，「大者恒大」的市场地位更加稳固。

惟消息一出，国内类比 IC 同业股价全面重挫，包括立锜、致新、类比科同创近期新低，但类比 IC 业者则一致指出，德仪过去与国内类比 IC 大厂的产品虽然重叠性高，但与国家半导体所主攻高毛利率的国防、军事、医疗等产品线，重叠性相当低，故德仪并购国家半导体，对国内类比 IC 厂商而言，短期并没有太大影响。

国内类比晶片以立锜居首，然立锜在全球类比晶片市场市占率仅 2-3%，而就算台湾所有的类比晶片厂加起来，占全球类比晶片市占率也只不过 5-6%，所以在全全球类比晶片这个战场而言，台厂仍算「小咖」，故 TI+NS 后，也不致于对国内类比晶片厂有什么太立即的影响。

然另一方面，当初国内的类比晶片窜起，成长性快速攀升，除了接日厂转单的替代效应以及 PC 品牌大厂把采购权下放给国内 ODM 厂，故给了国内类比 IC 厂快速发展的机会，另外，也有客户考量上游类比晶片的来源分散，以免一家厂商独大后，带来过度左右量/价上的供应风险，所以对于德仪并国家半导体，客户不一定乐观其成。

另外，以国家半导体近年的表现来看，其近一年的营收为 14.19 亿美元，近一年的净利约 2 亿美元，然德仪以每股 25 美元，一次付出共 65 亿美金的条件收购国家半导体，推升国家半导体在消息释出后隔天股价大涨逾 7 成，对于此溢价 78%的条件，德仪是否是「高价买下」以及是否可达成「1 加 1 大于 2」的交易，仍待观察。

IC 设计的并购风起云涌，产业的并购通常发生在景气低迷或开始反弹之际，而在金融海啸后，国内外即有不少晶片业者的并购，在国内尤其在网通晶片并购消息最多，几乎所有厂商都曾被点名，包括 2009 年雷凌与诚致宣布合并；而在驱动 IC 领域，在 2009 年底也不时传出旭曜与瑞鼎合并的讯息，而在 2011 年，除了联发科再并雷凌，站稳全球前十大 IC 设计厂外，类比 IC 厂中立锜、凌耀也不时传出合并案，整并话题不时在市场中流传。

而 IC 设计产业的并购原因，不外乎以下几点，包括产品面互补、扩大市占率、追求成长动能、扩大客户群以及提供客户一站购足的优势，追求所谓的「大者恒大」，但以 2008 年联阳四合一、到 2010 年雷凌合并诚致后短期所面临的毛利率压力以及股本扩大稀释 EPS 等因素，都令原本联姻的佳话，承受不少考验。

“十二五”期间将积极推进电子信息产业结构调整

2011年3月15日上午，“2011上海国际信息化博览会”在上海隆重开幕。工业和信息化部副部长刘利华出席开幕式并致辞。在上海期间，刘利华还与上海市副市长艾宝俊进行了会谈。

刘利华在致辞中指出，电子信息产业是全球经济增长的重要引擎，中国是全球电子信息产业发展的重要力量。过去的2010年，中国电子信息产业经受了国际金融危机的严峻考验，保持了平稳较快发展的良好势头。电子信息产业完成销售收入7.8万亿元，同比增长29.5%。电子信息产品进出口额超过1万亿美元，同比增长31.2%，占中国外贸总额的34.1%。主要电子产品产销持续增长，彩电、手机、微型计算机、数码相机等产品的产量均位居世界第一。科技创新成效显著，大规模集成电路等关键技术研发取得新进展，信息技术领域专利申请总量超过110万件。

刘利华强调，当前中国正在实施第十二个五年规划，电子信息产业迎来重要的发展机遇。作为行业主管部门，工业和信息化部将采取有力措施，促进电子信息产业实现又好又快发展。一是加强规划引导和政策扶持，营造促进产业发展的有利环境。二是积极推进产业结构调整，集中力量突破核心关键技术，增强产业核心竞争力。三是组织实施核心基础产业跃升计划，加速计算机、网络设备及智能终端产业发展，为产业发展培育新的增长点。四是深入开展信息技术应用，积极推进信息技术改造提升传统产业，促进信息化与工业化深度融合。

开幕式结束后，刘利华在部办公厅副主任王新哲、上海市经济和信息化委员会主任王坚等陪同下，参观了“2011上海国际信息化博览会”旗下的国际半导体设备、材料、制造和服务展览会，2011中国国际平面显示器件、设备材料及配套件展览会，2011中国国际太阳能技术展览会。

中国制造业发起“造心”攻势

今年是“十二五”开局之年，也被认为是我国打造创新型国家的关键之年。在产业竞争越来越全球化的今天，中国越来越重视国家产业发展和产业形象。

过去，中国的产业总体上还是“中国制造”标签下的世界加工厂，缺乏核心技术的低端制造与我国迅速崛起的经济实力和形象越来越不匹配。近年来已经有很多中国企业开始强化创新，在产业的核心科技领域谋求自主和超越。而这场“造心”运动也对“中国制造”向“中国创造”转型形成了强大的推力。

在未来五年时间里，我们的芯片产业将进一步提升核心竞争力，重塑中国本土制造业的形象，成为全球关注的焦点。

晶圆材料 5 月底恐断链

日本 311 强震至今，就在日本科技大厂开始陆续复工之际，近日内强度在 6 级以上的强烈余震不断，夏日限电问题又是箭在弦上，包括半导体用 12 寸矽晶圆、磊晶晶圆、砷化镓 (GaAs) 等化合物半导体晶圆等材料，供货短缺问题短期内难以解决，业界评估，最快 5 月下旬就会对生产链造成影响。

日本关东东北大地震发生至今，受到强烈余震及限电影响，包括信越化学 (Shin-Etsu) 子公司信越半导体的福岛白河厂、胜高 (SUMCO) 的山形米泽厂、及美国 MEMC 在日本宇都宫厂等 3 大矽晶圆生产据点，至今仍处于停工状态。而信越及 MEMC 宣布自本月中旬启动部份生产线，希望 5 月底前回复全产能量产，至于 SUMCO 则尚未公布复工时间。

台湾主要半导体厂第 1 季底时手中仍有 1.5 至 2 个月库存，撑到 6 月中下旬应该没有太大问题。但是，日本夏日限电政策，导致当地供应商无法全产能运行，若晶圆代工新订单持续涌入，导致库存快速去化，5 月底就会发生晶圆材料不足问题。

台积电全速进军 18 英寸晶圆时代

在日前于美国加州举行的 2011 年台积电技术研讨会 (Technology Symposium) 上，该公司透露了更多有关 18 英寸晶圆制造计划的细节。根据业界消息，台积电正全速进军 18 英寸晶圆技术领域，主要目的除了降低制造成本，也试图借此领先诸如 Globalfoundries、三星 (Samsung)、联电 (UMC) 等竞争对手一步。

台积电进军 18 英寸晶圆技术领域还有另一个动机——根据该公司资深研发副总裁蒋尚义 (Shang-Yi Chiang) 的说法，一旦进入 18 英寸晶圆时代，该公司所需的工程师人数也将减少；他在接受 EETimes 访问时表示，台积电进入 18 英寸晶圆制造约需十年的过渡期，届时所需的工程师人数会比现在少 7,000 人。

蒋尚义表示，台积电的 18 英寸晶圆制造将起始于 20 纳米制程节点；该公司一开始打算在新竹的 Fab12 晶圆厂建置一条 18 英寸晶圆试产线、采用 20 纳米制程，时程大概在 2013 到 2014 年间。而届时台积电的 12 英寸晶圆厂也将进入 20 纳米制程；蒋尚义表示，该公司的 20 纳米制程初产事实上也将以 12 英寸晶圆厂为主。

接下来，台积电计划在台中建置首座 18 英寸晶圆厂，也就是 Fab15，量产时程预定在 2015 到 2016 年之间。在起步阶段，该 18 英寸晶圆厂会采用 20 纳米制程，然后进入 14 纳米节点；而到 14 纳米节点，台积电打算在电晶体结构上进行转换。

在 20 纳米及以上节点，台积电将继续采用传统以 bulk CMOS 为基础的平面晶体管，但从 14 纳米节点开始，该公司将由 bulk CMOS 转向 FinFET 结构。也就是说，未来台积电将在 Fab15 进行 14 纳米 FinFET 的量产。

大陆矽晶圆厂 LDK 宣布跨入蓝宝石矽晶圆领域

2011年4月8日，中国大陆太阳能矽晶圆生产商江西赛维(LDKSolarCo.,Ltd.)发布新闻稿宣布，该公司决定投资4,000万美元在江西南昌县兴建一座蓝宝石矽晶圆厂房。若以2寸晶圆来计算，该座厂房的年产能将可达到200万片。LDK希望藉此抢食日益成长的LED商机。LDKADR8日终场持平于11.71美元。

包括LDK、太阳能设备提供商GTSolarInternational,Inc.在内的太阳能公司都开始将业务拓展至其他领域，希望藉此抵销欧洲各国调降太阳能补贴所造成的冲击。LED上游材料蓝宝石基板供应商RubiconTechnologyInc.在2月16日公布的第4季(2010年10-12月)财报、本季(1-3月)财测皆优于市场预期。Rubicon总裁兼执行长RajaParvez在财报新闻稿中指出，去(2010)年10-12月6寸抛光晶圆营收季增70%至810万美元；预估6寸晶圆下半年将强劲成长，主因愈来愈多LED晶片制造商宣布要在今年稍晚将生产线转移至6寸晶圆。

日本制造业向中国转移显加速苗头

日本大地震不仅使中国部分地区制造企业加快转型升级，也加速了日本制造业向中国转移的步伐。

日前，日本目前最大的汽车制动系统原厂供应商ADVICS株式会社，宣布成立ADVICS汽车制动系统中国研发中心。几乎同一时间，日本最大通信机箱机柜制造商日东工业株式会社也宣布增资中国，将中国公司注册资本从120万美元追加到1550万美元。

这些被业界解读为日本正加速将制造业向中国转移的信号。而与以往不同，一直被日本视为“高度机密”并“密闭”起来的核心技术，部分或将随之转移到中国。

事实上，此次大地震有可能会使日本很多前沿技术产品逐渐丧失其以往的优势。“比如，日本在汽车、面板、芯片等产品的供给减少，只会催生国际同行的扩张，从而降低自身的市场份额。因为这些产品并不都是绝对的日本企业所独有。”上述业内人士认为。

光伏和 LED**美国光伏项目未结订单超过 12GW 预示市场仍将增长**

根据 Solarbuzz 最新 4 月美国项目追踪报告 UnitedStatesDealTracker 分析, 现美国光伏项目未结订单已超过 12GW。尽管光伏产业目前受到了欧洲一些区域电价补贴政策的下调影响, 但是美国光伏项目未结订单的数字也预示着未来两年中美国是一个处于增长中的光伏市场。2010 年美国光伏市场规模是前一年的两倍, 预计 2011 年市场规模也将比 2010 年翻倍增长。

4 月 UnitedStatesDealTracker 报告中新增美国超过 375 个已在计划或是招标的非住宅项目, 同时也包括从 2010 年 1 月 1 日开始已安装或是正在安装的另外 775 个总规模超过 700MW 的光伏系统项目。

美国非住宅光伏项目规模从 50 千瓦至 100 兆瓦不等, 虽然公用事业公司的市场份额在不断增长, 自 2010 年 1 月起企业与政府项目仍然占项目总数的 76%。

根据报告中安装系统的价格数据, 大部分美国项目的安装系统价格在每瓦 3-4 美元左右, 非住宅光伏系统价格的下降是促进美国市场增长的重要因素。

中国企业积极布局南非 分食光伏“蛋糕”

近日, 南非公布了未来 20 年电力发展规划, 其中可再生能源发电能力将占全部新增发电能力的三分之一, 太阳能光伏发电(PV)将成新增发电能力的重要组成部分。由此, 正积极布局南非市场的中国光伏发电企业或将从中受益。

南非能源部对去年 10 月公布的《综合资源规划 2010(IRP 2010)》(下称“IRP 2010”)草案进行了修订, 南非政府内阁近日批准了该规划。“IRP 2010”勾勒出了从现在到 2030 年的未来 20 年南非电力供应与发展蓝图。

“IRP 2010”将为南非在未来 20 年 GDP 以年均 4.6% 的速度增长提供电力保证。根据修订后的规划, 在 2030 年之前, 南非部分发电厂要关停淘汰, 由此减少 10902 兆瓦的发电能力; 同时要新建 56539 兆瓦的发电能力。其中, 风力发电能力将达到 9200 兆瓦, 太阳能光伏发电(PV)为 8400 兆瓦, 集光型太阳能发电(CSP)为 1200 兆瓦。

对此, 作为在南非影响较大的光伏发电企业, 英利绿色能源控股有限公司(YGE.NYSE, 下称“英利新能源”)一位高层表示, 这对公司无疑是个好消息。英利新能源从去年开始在南非运作一个装机容量为 10MW 的太阳能光伏发电项目“南飞雁”, 还在肯尼亚、尼日利亚等非洲其他国家拥有零星的、规模较小的项目。

尽管南非光照条件很好, 适合光伏发电企业发展, 但据业内人士介绍, 其本身市场容量很低, 远不能和欧洲市场的需求相比。

光伏应用将帮助中国迎接气候变化和能源安全的双重挑战

随着中国经济的不断增长，带来的是能源需求快速增长。同时，作为世界大国，中国又在减少二氧化碳排放和能源结构调整方面做出了举世关注的承诺。在此背景下，中国面临着保持经济快速增长的同时应对能源需求和气候变化的双重挑战。诚然，中国政府承担了其作为大国的义务，采取了多项重要措施发展中国的新能源产业，不断提高非化石能源的投资力度，并制定了相关政策法规鼓励新能源领域的投资和应用。但在光伏应用方面，尚有极大的提高空间。需要政府投入更大幅度的支持力度和措施，以帮助这个新兴的产业为中国的能源需求和能源结构调整做出其应有的贡献。

在过去的数年中中国光伏企业经历了令人印象深刻的快速发展，中国一跃成为全球最为重要的光伏制造大国。中国光伏从业者的努力有效帮助了光伏制造成本在几年内有了显著下降。对比之下，中国在光伏应用领域的表现则没有如此耀眼。目前中国90%以上的光伏产品依赖于国外市场，面临着国际市场和贸易保护主义的风险。

中国不断增长的能源需求，气候变化带来的能源需求结构调整要求，以及中国光伏产业进一步健康发展的需要，都向中国的新能源部署提出了新的要求。政府及相关部门需要重新评估光伏发电的潜能，采取有效措施支持中国光伏产业的稳步发展。

我国在 LED 关键领域已有突破

500lm/\$将启动 LED 照明爆发式增长

2011年4月8日，由厦门市人民政府主办的2011中国（厦门）LED室内照明产业技术发展论坛在厦门国际会展中心召开。科技部副部长曹建林、中科院半导体研究所所长李晋闽、美国通用电气照明集团亚太总裁毕坚文、IEC国际标准项目组组长牟同升、国家半导体照明产业联盟副秘书长阮军、香港应科院副总裁吴恩柏、台湾晶电总经理特助王希维等国内外LED业界专家出席论坛并做主题演讲。SEMI中国作为特邀嘉宾单位出席了本次论坛。

李晋闽所长介绍了我国在半导体照明领域取得最新进展，据了解，我国在具有自主知识产权的关键设备MOCVD、HVPE以及在LED器件如深紫外LED等都取得了重大进展。采用国产MOCVD设备制造了蓝光LED芯片在20mA驱动电流下发光功率达到8.3mW,达到了国际先进水平，中科院半导体所设计的国产48片MOCVD机已经完成组装，已进入设备调试阶段。而HVPE设备有可能成为未来半导体照明的核心装备，目前也正在积极发展之中。另外中科院半导体所在深紫外LED、垂直结构LED芯片、纳米图形衬底等都取得了重大进展。尤其是在深紫外LED领域，不仅可以应用于照明领域，在生物领域也有很大的发展空间，采用深紫外LED对细菌杀菌率达到了90%以上。然而，李所长也提到，目前我国在LED照明关键领域仍然面临诸多问题和挑战：

研发投入不够，力量分散，资源不能共享以及低水平建设突出等等。

国家半导体照明产业联盟副秘书长阮军则指出，2010年我国LED产业整体规模已经达到1200亿元，未来5年仍然会以超过30%复合增长率增长，预计到2015年，我们LED产业规模将达到5000亿元。但目前我国LED企业规模小且分散，产业虽大但不强。因此，需要从国家层面进行统筹协调，加大对关键领域的投入来面对来自国际化的竞争。

中国LED和太阳能电池制造商获韩国市场青睐

2011年4月9日，在深圳召开的2011韩国电子展新闻发布会上，第42届韩国电子产业大展（KoreaElectronicsGrandFair2011,简称KEGF），将于10月12日~15日在韩国国际展览中心(KINTEX)举办。该展会展品涉及家电、尖端IT技术产品、电子元器件、半导体及汽车、建设等IT相融合的产品领域，预计展出规模达到5.3万平米，包括三星电子、LG电子、HP、3M、默克等在内的12个国家850个企业将参展。

韩国电子信息通信产业振兴会（KEA）郑镇宇本部长介绍，本届KEGF锁定当前炙手可热的“智能”电子产业，以“BeSmart”为主题，同期还将举办以智能整合为内容的“SmartConvergence2011”会议，邀请业内知名专家及著名企业CEO预测并提出未来市场的发展方向。此外，本届KEGF还将重点关注AppWorld、3D、数码广播、新一代计算机、绿色IT等热点，并将深入探究设计、研发、内容、流通等焦点性问题。

值得关注的是，今年的KEGF首次得到中国政府组团的关注，中国展商预计超过100家，成为最重要的国外展团之一。这与中韩两国的庞大经济合作规模密不可分。据韩国电子信息通信产业振兴会（KEA）的数据，2009年中国对韩国的投资总额达400亿美元，成为韩国最大的海外投资国；同时中国每年累计有500万人次赴韩国旅游，成为韩国最大的游客来源地。

近年来，由于韩国政府采取积极的国际贸易政策，韩国已成为中国出口型企业重点开拓的海外市场之一，KEGF日益受到中国政府和企业的关注。深圳市中小企业发展促进会理事长常远介绍，2010年深圳由120多人组团参加第41届韩国电子展，累计成交5.3亿人民币。

2011年全球LED晶粒价格有望年减约20%

据台湾相关业内人士指出，虽然中国大陆厂商近期大量申请MOCVD机台，不过受到LED人才、技术等方面缺乏影响，实际投入量产数量仅1/3，加上目前MOCVD机台出货前置期约需3-6个月，而良率调整、进入量产约需3个月，总计约需要6-9个月后新增产能才能发挥效用，因此不致于造成今年LED市场供过于求状况。

中国大陆大量添购MOCVD机台，为解决人才、技术门坎问题，中国大陆厂商频

频以高薪挖角台湾人才，减少学习曲线时间，而且一次就是一整组以上的人数，让台湾 LED 产业吹起「西进」跳槽风。

业内人士表示，中国大陆以国家政策扩展 LED 产业，从上游到下游积极布局，虽然中国大陆目前在技术方面与台厂仍有相当差距，不过厂商在政府政策力挺、拥有足够的资金挖角下，预期技术很快就能有相当的突破，相对来说，台厂除了在技术上应加快脚步外，于中国大陆市场的布局，以及和当地厂商的「合纵连横」策略要更积极展开部署，才不会被中国大陆厂商迎头赶上。

整体来看，随着中国大陆政府大力推动 LED 产业，MOCVD 设备数量全球比重仍将持续上升，未来仍有大量的产能产出，LED 价格也将下滑，某资深行业分析师日前预估，今年 LED 晶粒价格每季约有 5% 的下跌幅度，LED 价格有望年减约 20%，降幅仍在合理范围内，同时，价格滑落也可望进一步扩大 LED 市场加速普及率。

LED 照亮未来 带来产业发展重大机遇

“照明是人类的一项基本需求。传统的白炽灯、金卤灯、荧光灯等已存在和发展多年，已高度成熟，无论从光效上还是成本方面，已无发展空间。而白炽灯作为低效率照明典型代表，被淘汰已是不可逆转的必然趋势。随着 LED 照明的 Lm/\$ 的不断降低，而光效却在不断提高，到 2020 年，LED 照明将成为主流的照明光源。

但是目前 LED 产业也面临着诸多的挑战，但是挑战的背后却是蕴含着许多的产业发展机会。LED 制造行业可以借鉴大规模的集成电路半导体制造行业中很多经验和技術，可以说目前 LED 制造技术正在酝酿着一场技术革命。LED 无论从外延制造、芯片制程、封装测试等都有很大发展和提升空间。

针对 LED 性能提升和成本降低的迫切需求，半导体设备专业制造商则从服务于大规模集成电路制造业获得的经验中，推出了专门用于 LED 制造的检测、制造设备。可以说，LED 制造业正在面临着一场从借鉴吸收大规模集成电路行业发展经验的技术革命。这其中既充满着挑战，也带来了巨大的发展机遇。

物联网**首个物联网本科专业获批 南邮开始招生**

2011年3月28日,教育部公布的2010年度高等学校专业设备备案或审批结果(教高[2011]4号)中表示,批准南京邮电大学增设“物联网工程”、“测绘工程”专业申请,同时将在今年正式面向社会招生。南京邮电大学成为我国首座具有与物联网行业相关的本科专业学校。

由此可见,国家对于物联网行业尤为重视,而通过高等教育学校设立物联网本科专业,未来将为社会提供更多专业对口人才。

用户需求导向 智能导航应用引领汽车导航软时代

关于“苹果创新模式”的讨论,是近年来IT业界讨论的焦点话题。苹果模式的成功,其实是基于客户需求的变化与行业趋势市场需求的引领,这对于其他行业的发展也提供了借鉴意义,以汽车导航为例,使得如何快速、准确的获取相关交通信息成为车主顺畅出行的关键。而光靠汽车导航硬件技术远不能解决上述问题,关键还需要强大的软件相融合。

面对市场需求的新趋势,合众思壮任我游在GPS厂商中率先采用了“核心技术+软件平台”的模式,借助专业MiniSun3.0引擎的技术优势,开发3D实景导航、极速搜索、秒杀查询等实用导航功能。业内分析人士指出,随着全国各大城市道路拥堵情况愈发明显,更加智能化的汽车导航仪将受到消费者更多的热捧,这也将推动国内汽车导航市场消费理念的成熟化。

财政部: 物联网企业将获资金支持

2011年4月11日,财政部消息,中央财政预算将安排专项资金,用于支持物联网研发、应用和服务等方面,物联网企业的发展将迎来新的机遇。

专项资金的支持范围包括物联网的技术研发与产业化、标准研究与制订、应用示范与推广、公共服务平台等方面的项目。项目申报单位专业技术人员不少于15人,其中高级职称不少于5人;同时须拥有相应的专利、软件著作权或省部级以上认定的科技成果等研发成果,以及具有相应的市场应用基础。

专项资金的支持采用无偿资助或贷款贴息方式。申请专项资金的项目原则上只采用一种支持方式。其中无偿资助方式主要支持以自有资金为主投入的项目,贷款贴息方式主要支持以银行贷款为主投入的项目。

华润微电子 1200V Trench NPT IGBT 工艺平台开发成功

华润微电子有限公司（后简称“华润微电子”）宣布其附属公司华润上华科技有限公司（后简称“华润上华”）已开发完成 1200VTrenchNPTIGBT（沟槽非穿透型绝缘栅双极晶体管）工艺平台，各项参数均达到设计要求，成功进入 TrenchIGBT 代工市场。

华润上华开发的该工艺产品关键参数如最高耐压 $V(BR)_{CES}$ 、导通饱和电压 $V_{CE(on)}$ 、关断损耗 E_{off} ，以及在实际应用中的温升效果都与国际大厂相当，该工艺产品主要应用于电磁炉。根据国内权威的市场调查机构资料，2010 年中国电磁炉用 IGBT 的市场规模达 4.6 亿元人民币，预期 2011 年中国电磁炉用 IGBT 市场规模为 5.3 亿元人民币，较 2010 年成长 15.2%，到 2012 年与 2013 年分别达 6.1 亿元人民币与 7.0 亿元人民币，增长率分别为 15.1% 与 14.8%。

清华自主研发立体视频芯片

由清华大学自主研发的小小芯片将帮助人们实现在家里收看立体电视节目的愿望。据悉，装备这种芯片的国产 3D 电视机有望在今年 7 月上市。近日，清华大学发布了历经十余年攻关而研制成功的“清立方”立体视频芯片。

“清立方”芯片在平面视频立体转换、立体视频采集、制作、编码传输和播放等方面，形成了一系列自主知识产权的核心关键技术，为推动中国数字电视、移动终端与影视制作等产业迈进立体视频领域，提供了具有核心竞争力的高端技术支持。

山科大成功研制物联网网关芯片

日前，由山东科技大学信息学院教师陈新华、张德学研制的“32 位嵌入式 SoC 安全家电网关芯片—ORSoC”，在复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室测试成功，标志着这项成果在嵌入式 SoC 集成电路系统设计领域内的重大突破。

据介绍，这项成果来源于由青岛市科技局支持的“基于 OR1200 嵌入式 SoC 网关集成电路的设计及 AVS 实现”项目。SoC 安全家电网关芯片只需添加少量外部设备，即可应用于各种信息家电网关、物联网关，构建中高端消费电子产品、各种嵌入式系统、高实时性要求的各种控制系统和控制领域。

目前，这项成果已申请 3 项国家发明专利。它的研制成功也标志着山东科技大学已具备嵌入式 SoC 集成电路芯片全流程设计的能力，有助于改善目前国内多数网关和消费类电子应用国外芯片的状况，提高我国 IC 芯片自给率，帮助企业掌握核心技术，提高产品竞争力，对国内集成电路产业的发展具有十分重要的意义。

应用材料公司依托深紫外激光技术突破暗场晶圆检测极限

应用材料公司推出 AppliedDFinder 检测系统，用于在 22 纳米及更小技术节点的存储和逻辑芯片上检测极具挑战性的互连层。作为一项突破性的技术，该系统是首款采用深紫外（DUV）激光技术的暗场检测工具，使芯片制造商具有前所未有的能力，在生产环境中检测出图形化晶圆上极小的颗粒缺陷，从而提高产品良率。DFinder 系统专门针对互连层的检测而设计，因此总拥有成本比其它暗场检测系统最多可降低 40%。这对芯片制造而言是一项非常关键的优势，因为在这个过程中可能会涉及 50 多个独立的检测步骤。

DFinder 系统采用独一无二的 DUV 激光照明技术，可检测出 22 纳米技术节点上小至 40 纳米的所有应该被关注的颗粒缺陷，这比其它任何暗场检测系统所能识别的颗粒小 30% 以上。此外，该系统专有的掠射角光路和全偏振控制，可有效地将颗粒缺陷从晶圆图形上分离出来，从而既能找出所有影响良率的颗粒缺陷，又能将“错报”和滋扰缺陷误报降低一个数量级。这种区分晶圆图形和重要缺陷的卓越性能，让客户几乎可以避免使用那些既耗时又昂贵的非图形化测试晶圆。

西安交通大学成功研制高清立体显示处理芯片

西安交通大学 SoC 设计中心成功研制集成度约 350 万门的高清立体显示处理芯片 HMD100。

高清立体显示处理芯片 HMD100 是交大自主研发的专用于头戴式立体电视、微投影、3DTV 等产品领域的立体显示处理芯片。该芯片内嵌高性能的五通道视频 AFE（2 路标清、3 路高清）、2D/3D 自适应模拟视频解码器和立体显示处理引擎，最高支持 1080P 高清输入，具备 120Hz 帧频提升、双路独立视频缩放和高画质立体显示功能，实现大画面色串和噪声的消除、左右眼 60Hz 无闪烁的高清立体画面显示。

基于该芯片研制的头戴式立体电视，是一种采用高分辨率微显示屏进行近目光学放大的大屏幕移动显示装置，具有体积小、功耗低、视场大（60~70 英寸）、沉浸感强等特点，在消费电子、虚拟现实、国防、医疗、远程教育等领域具有广阔的应用前景。该课题组在数字电视、新型显示处理技术方向已形成由近 30 项发明专利构成的自主知识产权专利池。

关于 2011 年集成电路设计企业认定和年审的通知

集成电路设计企业认定和年审工作是执行优惠政策的基础,根据国发 [2011]4 号文件的要求,及工业和信息化部关于集成电路设计企业认定和年审工作的指示,中国半导体行业协会从现在开始 2011 年度的集成电路设计企业认定和年审工作。凡申报 2011 年度“集成电路设计企业”认定和年审的企业,上报材料的截止日期为 2011 年 6 月 30 日。

按规定需要进行 2011 年的企业年度审查的企业为:“工信部电子[2010]609 号关于印发《集成电路设计企业名单(第八批)的通知》”批准的 54 家企业和“工信部电子[2010]610 号关于印发《2010 年度通过的集成电路设计企业名单》的通知”批准的 278 家企业。在中国半导体行业协会认定和年审的企业,请于 6 月 30 日前提交年审材料。

集成电路设计企业每年进行一次企业认定和年审。如果企业名称等事项有变更,需出具当地工商局的企业名称变更核准通知书、新的企业营业执照复印件,企业更名报告和年审材料一起报来,才能进行年审。

联系人:张生文(zsw@csia.net.cn)、白洁(bj@csia.net.cn)

电话:010-68208564 传真:010-68208587

地址:北京市万寿路 27 号电子大厦 0316 室 邮编:100846

本地联系:张凡 88328230-8039 zhangfan@xaic.com.cn

关于组团参展深圳集成电路创新应用展的通知

由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市科学技术协会主办、陕西省半导体行业协会协办的深圳集成电路创新应用展将于 2011 年 6 月 28 日-29 日在深圳会展中心 3 号馆举办。

作为国内首创的系统方案和创新应用展示平台,“深圳集成电路创新应用展”立足于中国电子设计制造中心珠三角地区,以应用和创新为主线,整合上下游供应链资源,通过系统方案展示、高峰论坛、开放式技术研讨等形式,帮助电子制造厂商的技术决策人员了解最新技术,获取应用方案,把握市场发展趋势。“深圳集成电路创新应用展”作为“泛珠三角集成电路产品展示暨高峰论坛”系列活动的延伸,已成为华南地区集成电路领域极具影响力的行业盛会,同时也是电子制造商了解供应商,选择技术合作

伙伴的最佳平台。

一、展会主题：

手机/便携消费电子 三网融合与数字家庭

工业/安防/医疗电子

新能源 IC 设计服务与制造

二、展览范围：

IP 提供商 IC 设计公司 EDA 工具 分销商/代理商

封测 方案商 IC 设计服务 系统软件提供商 晶元加工

陕西省半导体行业协会特组织本地企业参展，有意者请与我们联系。

联系人：严越 88328230-8018 yanyue@xaic.com.cn

高博 88328230-8015 gaobo@xaic.com.cn

关于陕西省半导体行业协会会费的通知

会费是协会开展工作、组织活动的保证。省半导体行业协会根据工作安排和会员单位的需要进行行业、政策以及相关技术的交流，协会还编辑了《简讯》，及时向会员单位发送。在 2011 年里，我们希望会员单位积极交纳会费，使协会各项工作更加蓬勃地开展，现将有关事项通知如下：

1、请贵单位接此通知后，将 2011 年会费从银行汇款至陕西省半导体行业协会，并请将会费记帐凭证传真（附凭证格式）；

汇款信息如下：

单位：陕西省半导体行业协会

开户银行：交通银行西安分行软件园支行

帐号：611301134018001274988

2、年会费标准：常务理事全年会费 2000 元，理事单位年会费 1500 元，普通会员单位年会费 1000 元。

联系人：严越 电话：029-88328230-8018 传真：029-88316024

陕西省半导体行业协会

二〇一一年四月十五日

《陕西省半导体行业》简讯 (双月刊)

地 址：陕西省西安市高新六路腾飞创新中心A-2-9

电 话：029-88328230 邮 编：710075

传 真：029-88316024 E-mail: gaobo@xaic.com.cn

联系人：高博 严越

联系电话：029-88328230-8015

029-88328230-8018